

APÊNDICE I

LISTA DE ITENS NCM SH-2007 SUJEITOS A REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ORIGEM

Os itens tarifários que não estão listados no presente Apêndice estarão sujeitos às disposições previstas no Artigo 3º incisos a) a f)

NCM SH-2007	Requisito de Origem
0401.10.10	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
0401.10.90	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
0401.20.10	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
0401.20.90	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
0401.30.10	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
0402.10.10	Deverão ser elaborados a partir de leite produzido nos Estados Partes.
0402.10.90	Deverão ser elaborados a partir de leite produzido nos Estados Partes.
0402.21.10	Deverão ser elaborados a partir de leite produzido nos Estados Partes.
0402.21.20	Deverão ser elaborados a partir de leite produzido nos Estados Partes.
0402.29.10	Deverão ser elaborados a partir de leite produzido nos Estados Partes.
0402.29.20	Deverão ser elaborados a partir de leite produzido nos Estados Partes.
0405.10.00	Deverão ser elaborados a partir de leite produzido nos Estados Partes.
0408.11.00	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
0408.91.00	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
1302.13.00	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
1507.10.00	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
1507.90.11	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
1507.90.19	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
1508.10.00	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
1508.90.00	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
1511.10.00	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
1511.90.00	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
1512.11.10	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
1512.19.11	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
1512.19.19	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
1512.21.00	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
1512.29.10	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
1513.11.00	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
1513.21.10	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
1513.29.10	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
1515.29.10	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
1515.29.90	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
1515.90.10	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
1516.10.00	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.

8433.59.90	60% de valor agregado regional.
8433.60.10	60% de valor agregado regional.
8433.60.21	60% de valor agregado regional.
8433.60.29	60% de valor agregado regional.
8433.60.90	60% de valor agregado regional.
8433.90.90	60% de valor agregado regional.
8434.10.00	60% de valor agregado regional.
8434.20.10	60% de valor agregado regional.
8434.20.90	60% de valor agregado regional.
8434.90.00	60% de valor agregado regional.
8435.10.00	60% de valor agregado regional.
8435.90.00	60% de valor agregado regional.
8436.10.00	60% de valor agregado regional.
8436.21.00	60% de valor agregado regional.
8436.29.00	60% de valor agregado regional.
8436.80.00	60% de valor agregado regional.
8436.91.00	60% de valor agregado regional.
8436.99.00	60% de valor agregado regional.
8437.10.00	60% de valor agregado regional.
8437.80.10	60% de valor agregado regional.
8437.80.90	60% de valor agregado regional.
8437.90.00	60% de valor agregado regional.
8438.10.00	60% de valor agregado regional.
8438.20.11	60% de valor agregado regional.
8438.20.19	60% de valor agregado regional.
8438.20.90	60% de valor agregado regional.
8438.30.00	60% de valor agregado regional.
8438.40.00	60% de valor agregado regional.
8438.50.00	60% de valor agregado regional.
8438.60.00	60% de valor agregado regional.
8438.80.10	60% de valor agregado regional.
8438.80.20	60% de valor agregado regional.
8438.80.90	60% de valor agregado regional.
8438.90.00	60% de valor agregado regional.
8439.10.10	60% de valor agregado regional.
8439.10.20	60% de valor agregado regional.
8439.10.30	60% de valor agregado regional.
8439.10.90	60% de valor agregado regional.
8439.20.00	60% de valor agregado regional.
8439.30.10	60% de valor agregado regional.
8439.30.20	60% de valor agregado regional.
8439.30.30	60% de valor agregado regional.
8439.30.90	60% de valor agregado regional.
8439.91.00	60% de valor agregado regional.
8439.99.10	60% de valor agregado regional.
8439.99.90	60% de valor agregado regional.
8440.10.11	60% de valor agregado regional.
8440.10.20	60% de valor agregado regional.
8440.10.90	60% de valor agregado regional.
8440.90.00	60% de valor agregado regional.
8441.10.10	60% de valor agregado regional.
8441.10.90	60% de valor agregado regional.
8441.20.00	60% de valor agregado regional.
8441.30.10	60% de valor agregado regional.
8441.30.90	60% de valor agregado regional.
8441.40.00	60% de valor agregado regional.
8441.80.00	60% de valor agregado regional.
8441.90.00	60% de valor agregado regional.
8442.30.10	60% de valor agregado regional.
8442.30.20	60% de valor agregado regional.
8442.30.90	60% de valor agregado regional.
8442.40.10	60% de valor agregado regional.
8442.40.20	60% de valor agregado regional.
8442.40.90	60% de valor agregado regional.
8442.50.00	60% de valor agregado regional.
8443.11.10	60% de valor agregado regional.
8443.11.90	60% de valor agregado regional.
8443.12.00	60% de valor agregado regional.
8443.13.10	60% de valor agregado regional.
8443.13.21	60% de valor agregado regional.
8443.13.29	60% de valor agregado regional.
8443.13.90	60% de valor agregado regional.
8443.14.00	60% de valor agregado regional.
8443.15.00	60% de valor agregado regional.
8443.16.00	60% de valor agregado regional.
8443.17.10	60% de valor agregado regional.
8443.17.90	60% de valor agregado regional.
8443.19.10	60% de valor agregado regional.
8443.19.90	60% de valor agregado regional.
8443.31.00	60% de valor agregado regional.
8443.32.11	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.

8443.32.59	<p>Cumprir com o seguinte processo produtivo:</p> <p>A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso;</p> <p>B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e</p> <p>C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores.</p> <p>Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.</p>
8443.39.10	60% de valor agregado regional.
8443.39.21	60% de valor agregado regional.
8443.39.28	60% de valor agregado regional.
8443.39.29	60% de valor agregado regional.
8443.39.30	60% de valor agregado regional.
8443.39.90	60% de valor agregado regional.
8443.91.10	60% de valor agregado regional.
8443.91.91	60% de valor agregado regional.
8443.91.92	60% de valor agregado regional.
8443.91.99	60% de valor agregado regional.
8443.99.11	CIRCUITOS IMPRESSOS MONTADOS COM COMPONENTES ELÉTRICOS OU ELETRÔNICOS. Montagem e soldagem nas placas de circuito impresso de todos os componentes, sempre que estes não partam da subposição 8473.30.
8443.99.13	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8443.99.19	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8443.99.21	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. <p>Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.</p>
8443.99.24	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. <p>Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.</p>
8443.99.31	60% de valor agregado regional.
8443.99.39	60% de valor agregado regional.
8444.00.10	60% de valor agregado regional.
8444.00.20	60% de valor agregado regional.
8444.00.90	60% de valor agregado regional.
8445.11.10	60% de valor agregado regional.
8445.11.20	60% de valor agregado regional.
8445.11.90	60% de valor agregado regional.
8445.12.00	60% de valor agregado regional.
8445.13.00	60% de valor agregado regional.
8445.19.10	60% de valor agregado regional.
8445.19.21	60% de valor agregado regional.
8445.19.22	60% de valor agregado regional.
8445.19.23	60% de valor agregado regional.
8445.19.24	60% de valor agregado regional.
8445.19.25	60% de valor agregado regional.
8445.19.26	60% de valor agregado regional.
8445.19.27	60% de valor agregado regional.
8445.19.29	60% de valor agregado regional.
8445.20.00	60% de valor agregado regional.
8445.30.10	60% de valor agregado regional.
8445.30.90	60% de valor agregado regional.
8445.40.11	60% de valor agregado regional.
8445.40.12	60% de valor agregado regional.
8445.40.18	60% de valor agregado regional.
8445.40.19	60% de valor agregado regional.
8445.40.21	60% de valor agregado regional.
8445.40.29	60% de valor agregado regional.
8445.40.31	60% de valor agregado regional.
8445.40.39	60% de valor agregado regional.
8445.40.40	60% de valor agregado regional.
8445.40.90	60% de valor agregado regional.
8445.90.10	60% de valor agregado regional.
8445.90.20	60% de valor agregado regional.
8445.90.30	60% de valor agregado regional.
8445.90.40	60% de valor agregado regional.
8445.90.90	60% de valor agregado regional.
8446.10.10	60% de valor agregado regional.
8446.10.90	60% de valor agregado regional.
8446.21.00	60% de valor agregado regional.
8446.29.00	60% de valor agregado regional.
8446.30.10	60% de valor agregado regional.

8462.10.19	60% de valor agregado regional.
8462.10.90	60% de valor agregado regional.
8462.21.00	60% de valor agregado regional.
8462.29.00	60% de valor agregado regional.
8462.31.00	60% de valor agregado regional.
8462.39.10	60% de valor agregado regional.
8462.39.90	60% de valor agregado regional.
8462.41.00	60% de valor agregado regional.
8462.49.00	60% de valor agregado regional.
8462.91.11	60% de valor agregado regional.
8462.91.19	60% de valor agregado regional.
8462.91.91	60% de valor agregado regional.
8462.91.99	60% de valor agregado regional.
8462.99.10	60% de valor agregado regional.
8462.99.20	60% de valor agregado regional.
8462.99.90	60% de valor agregado regional.
8463.10.10	60% de valor agregado regional.
8463.10.90	60% de valor agregado regional.
8463.20.10	60% de valor agregado regional.
8463.20.91	60% de valor agregado regional.
8463.20.99	60% de valor agregado regional.
8463.30.00	60% de valor agregado regional.
8463.90.10	60% de valor agregado regional.
8463.90.90	60% de valor agregado regional.
8464.10.00	60% de valor agregado regional.
8464.20.10	60% de valor agregado regional.
8464.20.21	60% de valor agregado regional.
8464.20.29	60% de valor agregado regional.
8464.20.90	60% de valor agregado regional.
8464.90.11	60% de valor agregado regional.
8464.90.19	60% de valor agregado regional.
8464.90.90	60% de valor agregado regional.
8465.10.00	60% de valor agregado regional.
8465.91.10	60% de valor agregado regional.
8465.91.20	60% de valor agregado regional.
8465.91.90	60% de valor agregado regional.
8465.92.11	60% de valor agregado regional.
8465.92.19	60% de valor agregado regional.
8465.92.90	60% de valor agregado regional.
8465.93.10	60% de valor agregado regional.
8465.93.90	60% de valor agregado regional.
8465.94.00	60% de valor agregado regional.
8465.95.11	60% de valor agregado regional.
8465.95.12	60% de valor agregado regional.
8465.95.91	60% de valor agregado regional.
8465.95.92	60% de valor agregado regional.
8465.96.00	60% de valor agregado regional.
8465.99.00	60% de valor agregado regional.
8466.10.00	60% de valor agregado regional.
8466.20.10	60% de valor agregado regional.
8466.20.90	60% de valor agregado regional.
8466.30.00	60% de valor agregado regional.
8466.91.00	60% de valor agregado regional.
8466.92.00	60% de valor agregado regional.
8466.93.11	60% de valor agregado regional.
8466.93.19	60% de valor agregado regional.
8466.93.20	60% de valor agregado regional.
8466.93.30	60% de valor agregado regional.
8466.93.40	60% de valor agregado regional.
8466.93.50	60% de valor agregado regional.
8466.93.60	60% de valor agregado regional.
8466.94.10	60% de valor agregado regional.
8466.94.20	60% de valor agregado regional.
8466.94.30	60% de valor agregado regional.
8466.94.90	60% de valor agregado regional.
8467.11.10	60% de valor agregado regional.
8467.11.90	60% de valor agregado regional.
8467.19.00	60% de valor agregado regional.
8467.29.93	60% de valor agregado regional.
8467.81.00	60% de valor agregado regional.
8467.89.00	60% de valor agregado regional.
8467.91.00	60% de valor agregado regional.
8467.92.00	60% de valor agregado regional.
8467.99.00	60% de valor agregado regional.
8468.20.00	60% de valor agregado regional.
8468.80.10	60% de valor agregado regional.
8468.80.90	60% de valor agregado regional.
8468.90.20	60% de valor agregado regional.
8468.90.90	60% de valor agregado regional.
8469.00.10	60% de valor agregado regional.
8470.50.11	<p>Cumprir com o seguinte processo produtivo:</p> <p>A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso;</p> <p>B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes;</p> <p>C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores.</p> <p>Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.</p>

8470.50.19	<p>Cumprir com o seguinte processo produtivo:</p> <p>A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso;</p> <p>B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e</p> <p>C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores.</p> <p>Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.</p>
8470.50.90	60% de valor agregado regional.
8470.90.10	60% de valor agregado regional.
8470.90.90	60% de valor agregado regional.
8471.30.12	<p>MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS. Cumprir com o seguinte processo produtivo:</p> <p>A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso que implementem as funções de processamento e memória, as controladoras de periféricos para teclado, e unidades de discos magnéticos e as interfaces de comunicação serial e paralela, cumulativamente. Quando as unidades centrais de processamento incorporarem no mesmo corpo ou gabinete, placas de circuito impresso que implementem as funções de rede local ou emulação de terminal, estas placas também deverão ter a montagem e soldagem de todos seus componentes;</p> <p>B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e</p> <p>C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores.</p> <p>Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Tela ("display") dos itens 8473.30.91 e 8473.30.92; e 2) Teclado do item 8471.60.52. Não descaracteriza o cumprimento do regime de origem definido a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.</p>
8471.30.19	<p>MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS. Cumprir com o seguinte processo produtivo:</p> <p>A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso que implementem as funções de processamento e memória, as controladoras de periféricos para teclado, e unidades de discos magnéticos e as interfaces de comunicação serial e paralela, cumulativamente. Quando as unidades centrais de processamento incorporarem no mesmo corpo ou gabinete, placas de circuito impresso que implementem as funções de rede local ou emulação de terminal, estas placas também deverão ter a montagem e soldagem de todos seus componentes;</p> <p>B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e</p> <p>C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores.</p> <p>Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Tela ("display") dos itens 8473.30.91 e 8473.30.92; e 2) Teclado do item 8471.60.52. Não descaracteriza o cumprimento do regime de origem definido a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.</p>
8471.30.90	<p>Cumprir com o seguinte processo produtivo:</p> <p>A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso;</p> <p>B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e</p> <p>C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores.</p> <p>Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.</p>
8471.41.90	<p>Cumprir com o seguinte processo produtivo:</p> <p>A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso;</p> <p>B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e</p> <p>C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores.</p> <p>Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.</p>
8471.50.10	<p>UNIDADES DIGITAIS DE PROCESSAMENTO DE PEQUENA CAPACIDADE. Cumprir com o seguinte processo produtivo:</p> <p>A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso que implementem as funções de processamento e memória e as seguintes interfaces: em série, paralela, de unidades de discos magnéticos, de teclado e de vídeo, cumulativamente. Quando as unidades centrais de processamento incorporem no mesmo corpo o gabinete placas de circuito impresso que implementem as funções de rede local ou emulação de terminal, estas placas também deverão ter uma montagem e soldagem de todos os componentes.</p> <p>B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e</p> <p>C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Não descaracteriza o cumprimento do Regime de Origem definido, a inclusão no mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.</p> <p>Nas unidades digitais de processamento do tipo "diskless", destinadas à interconexão em redes locais, a montagem da placa que implementa a interface de rede local poderá substituir a montagem das placas que implementam as interfaces em série, paralela e de unidades de discos magnéticos;</p>
8471.50.20	<p>UNIDADES DIGITAIS DE CAPACIDADE MÉDIA E GRANDE. Cumprir com o seguinte processo produtivo:</p> <p>A. Montagem e soldagem de todos os componentes no conjunto de placas de circuito impresso que implementem como mínimo 3 (três) das 5 (cinco) seguintes funções: a) processamento central; b) memória; c) unidade de controle integrada/interface ou controladoras de periféricos; d) suporte e diagnóstico de sistema; e) canal ou interface de comunicação com unidade de entrada e saída de dados e periféricos; ou, alternativamente, a montagem de pelo menos 4 (quatro) placas de circuito impresso que implementem qualquer destas funções;</p> <p>B. Montagem e integração das placas de circuito impresso e dos conjuntos elétricos e mecânicos na formação do produto final; e</p> <p>C. Quando a montagem do produto se realize com conjuntos em forma de gaveta, estes conjuntos deverão ser montados a partir de seus subconjuntos, tais como: fontes de alimentação, placas de circuito impresso e cabos.</p> <p>Quando a empresa opte pela montagem do número de placas de circuito impresso, estabelecido no item "A", no caso de que se utilizem placas que sejam padrões do mercado, como por exemplo, placas de memória do tipo "SIMM" do item 8473.30.42 ou 8473.50.50, será considerada uma placa por função, independentemente da quantidade de placas montadas para implementar a função. Para cumprir com o disposto se admitirá a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A", "B" e "C". O disposto neste Regime também se aplica às unidades de controle de periféricos, tais como controladores de discos, fitas, impressoras e leitores ópticas e/ou magnéticas e às expansões das funções mencionadas no item "A", inclusive quando não se apresentem no mesmo corpo ou gabinete das unidades digitais de processamento.</p>
8471.50.30	<p>UNIDADES DIGITAIS DE CAPACIDADE MÉDIA E GRANDE. Cumprir com o seguinte processo produtivo:</p> <p>A. Montagem e soldagem de todos os componentes no conjunto de placas de circuito impresso que implementem como mínimo 3 (três) das 5 (cinco) seguintes funções: a) processamento central; b) memória; c) unidade de controle integrada/interface ou controladoras de periféricos; d) suporte e diagnóstico de sistema; e) canal ou interface de comunicação com unidade de entrada e saída de dados e periféricos; ou, alternativamente, a montagem de pelo menos 4 (quatro) placas de circuito impresso que implementem qualquer destas funções;</p> <p>B. Montagem e integração das placas de circuito impresso e dos conjuntos elétricos e mecânicos na formação do produto final; e</p> <p>C. Quando a montagem do produto se realize com conjuntos em forma de gaveta, estes conjuntos deverão ser montados a partir de seus subconjuntos, tais como: fontes de alimentação, placas de circuito impresso e cabos.</p> <p>Quando a empresa opte pela montagem do número de placas de circuito impresso, estabelecido no item "A", no caso de que se utilizem placas que sejam padrões do mercado, como por exemplo, placas de memória do tipo "SIMM" do item 8473.30.42 ou 8473.50.50, será considerada uma placa por função, independentemente da quantidade de placas montadas para implementar a função. Para cumprir com o disposto se admitirá a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A", "B" e "C". O disposto neste Regime também se aplica às unidades de controle de periféricos, tais como controladores de discos, fitas, impressoras e leitores ópticas e/ou magnéticas e às expansões das funções mencionadas no item "A", inclusive quando não se apresentem no mesmo corpo ou gabinete das unidades digitais de processamento.</p>

8471.50.40	<p>UNIDADES DIGITAIS DE CAPACIDADE MUITO GRANDE. Cumprir com o seguinte processo produtivo:</p> <p>A. Montagem e soldagem de todos os componentes no conjunto de placas de circuito impresso que implementem pelo menos 2 (duas) das 5 (cinco) seguintes funções: a) processamento central; b) memória; c) unidade de controle integrada/interface; d) suporte e diagnóstico de sistemas; e) canal de comunicação, ou alternativamente, a montagem de pelo menos 3 (três) placas de circuito impresso que implementem qualquer destas funções;</p> <p>B. Montagem e integração das placas de circuito impresso e dos conjuntos elétricos e mecânicos na formação do produto final; e</p> <p>C. Quando a montagem do produto se realize com conjuntos em forma de gaveta, estes conjuntos deverão ser montados a partir de seus subconjuntos, tais como: fontes de alimentação, placas de circuito impresso e cabos.</p> <p>Quando a empresa opte pela montagem do número de placas de circuito impresso, estabelecido no item "A", no caso de que se utilizem placas que sejam padrões do mercado, como por exemplo, placas de memória do tipo "SIMM" do item 8473.30.42 ou 8473.50.50, será considerada uma placa por função, independentemente da quantidade de placas montadas para implementar a função. Para cumprir com o disposto se admitirá a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A", "B" e "C". O disposto neste Regime também se aplica às unidades de controle de periféricos, tais como controladores de discos, fitas, impressoras e leitores ópticas e/ou magnéticas e às expansões das funções mencionadas no item "A", inclusive quando não se apresentem no mesmo corpo ou gabinete das unidades digitais de processamento.</p>
8471.50.90	<p>Cumprir com o seguinte processo produtivo:</p> <p>A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso;</p> <p>B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e</p> <p>C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores.</p> <p>Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.</p>
8471.60.52	<p>Cumprir com o seguinte processo produtivo:</p> <p>A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso;</p> <p>B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e</p> <p>C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores.</p> <p>Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.</p>
8471.60.53	<p>Cumprir com o seguinte processo produtivo:</p> <p>A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso;</p> <p>B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e</p> <p>C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores.</p> <p>Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.</p>
8471.60.59	<p>Cumprir com o seguinte processo produtivo:</p> <p>A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso;</p> <p>B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e</p> <p>C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores.</p> <p>Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.</p>
8471.60.61	<p>Cumprir com o seguinte processo produtivo:</p> <p>A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso;</p> <p>B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e</p> <p>C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores.</p> <p>Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.</p>
8471.60.62	<p>Cumprir com o seguinte processo produtivo:</p> <p>A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso;</p> <p>B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e</p> <p>C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores.</p> <p>Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.</p>
8471.60.80	<p>Cumprir com o seguinte processo produtivo:</p> <p>A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso;</p> <p>B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e</p> <p>C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores.</p> <p>Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.</p>
8471.60.90	<p>Cumprir com o seguinte processo produtivo:</p> <p>A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso;</p> <p>B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e</p> <p>C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores.</p> <p>Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.</p>
8471.70.12	<p>DISCOS RÍGIDOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo:</p> <p>A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso;</p> <p>B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes;</p> <p>C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B";</p> <p>D. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes, por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B"; e</p> <p>E. Para a produção de discos magnéticos rígidos com capacidade de armazenamento superior a 1 (um) GBYTE por HDA (Head Disk Assembly) não formatado, poderá ser feita a opção entre cumprir com o disposto nos itens "A" ou "B", sendo que, no caso do cumprimento do disposto no item "A" deverão ser soldados e montados todos os componentes nas placas de circuito impresso que implementem pelo menos duas das seguintes funções: a) comunicação com a unidade controladora de disco; b) posicionamento dos conjuntos de leitura e gravação; c) leitura e gravação.</p>

8473.30.99	<p>Cumprir com o seguinte processo produtivo:</p> <p>A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso;</p> <p>B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e</p> <p>C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores.</p> <p>Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.</p>
8473.40.10	CIRCUITOS IMPRESSOS MONTADOS COM COMPONENTES ELÉTRICOS OU ELETRÔNICOS. Montagem e soldagem nas placas de circuito impresso de todos os componentes, sempre que estes não partam da subposição 8473.30.
8473.50.10	CIRCUITOS IMPRESSOS MONTADOS COM COMPONENTES ELÉTRICOS OU ELETRÔNICOS. Montagem e soldagem nas placas de circuito impresso de todos os componentes, sempre que estes não partam da subposição 8473.30.
8473.50.32	<p>Cumprir com o seguinte processo produtivo:</p> <p>A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso;</p> <p>B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e</p> <p>C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores.</p> <p>Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.</p>
8473.50.39	<p>Cumprir com o seguinte processo produtivo:</p> <p>A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso;</p> <p>B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e</p> <p>C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores.</p> <p>Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.</p>
8473.50.50	PLACAS (MÓDULOS DE MEMÓRIA) COM UMA SUPERFÍCIE INFERIOR OU IGUAL A 50 CM ² . REQUISITO: Cumprir com o seguinte processo produtivo:
	A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada;
	B. Encapsulamento da pastilha;
	C. Teste (ensaio) elétrico;
	D. Marcação (identificação) do componente (memória); e
	E. Montagem e soldagem dos componentes semicondutores (memória) no circuito impresso.
8473.50.90	<p>Cumprir com o seguinte processo produtivo:</p> <p>A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso;</p> <p>B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e</p> <p>C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores.</p> <p>Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.</p>
8474.10.00	60% de valor agregado regional.
8474.20.10	60% de valor agregado regional.
8474.20.90	60% de valor agregado regional.
8474.31.00	60% de valor agregado regional.
8474.32.00	60% de valor agregado regional.
8474.39.00	60% de valor agregado regional.
8474.80.10	60% de valor agregado regional.
8474.80.90	60% de valor agregado regional.
8474.90.00	60% de valor agregado regional.
8475.10.00	60% de valor agregado regional.
8475.21.00	60% de valor agregado regional.
8475.29.10	60% de valor agregado regional.
8475.29.90	60% de valor agregado regional.
8475.90.00	60% de valor agregado regional.
8476.21.00	60% de valor agregado regional.
8476.29.00	60% de valor agregado regional.
8476.81.00	60% de valor agregado regional.
8476.89.10	60% de valor agregado regional.
8476.89.90	60% de valor agregado regional.
8476.90.00	60% de valor agregado regional.
8477.10.11	60% de valor agregado regional.
8477.10.19	60% de valor agregado regional.
8477.10.21	60% de valor agregado regional.
8477.10.29	60% de valor agregado regional.
8477.10.91	60% de valor agregado regional.
8477.10.99	60% de valor agregado regional.
8477.20.10	60% de valor agregado regional.
8477.20.90	60% de valor agregado regional.
8477.30.10	60% de valor agregado regional.
8477.30.90	60% de valor agregado regional.
8477.40.10	60% de valor agregado regional.
8477.40.90	60% de valor agregado regional.
8477.51.00	60% de valor agregado regional.
8477.59.11	60% de valor agregado regional.
8477.59.19	60% de valor agregado regional.
8477.59.90	60% de valor agregado regional.
8477.80.10	60% de valor agregado regional.
8477.80.90	60% de valor agregado regional.
8477.90.00	60% de valor agregado regional.
8478.10.10	60% de valor agregado regional.
8478.10.90	60% de valor agregado regional.
8478.90.00	60% de valor agregado regional.
8479.10.10	60% de valor agregado regional.
8479.10.90	60% de valor agregado regional.
8479.20.00	60% de valor agregado regional.
8479.30.00	60% de valor agregado regional.
8479.40.00	60% de valor agregado regional.

8502.40.10	60% de valor agregado regional.
8502.40.90	60% de valor agregado regional.
8503.00.90	60% de valor agregado regional.
8504.21.00	60% de valor agregado regional.
8504.22.00	60% de valor agregado regional.
8504.23.00	60% de valor agregado regional.
8504.33.00	60% de valor agregado regional.
8504.34.00	60% de valor agregado regional.
8504.40.30.	60% de valor agregado regional.
8504.40.50	60% de valor agregado regional.
8504.40.90	60% de valor agregado regional.
8504.90.30	60% de valor agregado regional.
8504.90.40	60% de valor agregado regional.
8505.20.10	60% de valor agregado regional.
8505.20.90	60% de valor agregado regional.
8505.90.80	60% de valor agregado regional.
8505.90.90	60% de valor agregado regional.
8508.60.00	60% de valor agregado regional.
8510.20.00	60% de valor agregado regional.
8510.90.90	60% de valor agregado regional.
8511.80.30	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o cumprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.
8514.10.10	60% de valor agregado regional.
8514.10.90	60% de valor agregado regional.
8514.20.11	60% de valor agregado regional.
8514.20.19	60% de valor agregado regional.
8514.20.20	60% de valor agregado regional.
8514.30.11	60% de valor agregado regional.
8514.30.19	60% de valor agregado regional.
8514.30.21	60% de valor agregado regional.
8514.30.29	60% de valor agregado regional.
8514.30.90	60% de valor agregado regional.
8514.40.00	60% de valor agregado regional.
8514.90.00	60% de valor agregado regional.
8515.11.00	60% de valor agregado regional.
8515.19.00	60% de valor agregado regional.
8515.21.00	60% de valor agregado regional.
8515.29.00	60% de valor agregado regional.
8515.31.10	60% de valor agregado regional.
8515.31.90	60% de valor agregado regional.
8515.39.00	60% de valor agregado regional.
8515.80.10	60% de valor agregado regional.
8515.80.90	60% de valor agregado regional.
8515.90.00	60% de valor agregado regional.
8517.12.11	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8517.12.12	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8517.12.13	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8517.12.19	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8517.12.21	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8517.12.22	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8517.12.23	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8517.12.29	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.

8517.62.79	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8517.62.91	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8517.62.93	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8517.62.94	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.
8517.62.95	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8517.62.96	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8517.70.10	Circuitos impressos montados com componentes elétricos ou eletrônicos. Montagem e soldagem nas placas de circuito impresso de todos os componentes, sempre que estes não partam da subposição 8473.30
8517.70.92	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8517.70.99	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.

8518.10.10	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8518.29.10	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8519.81.20	60% de valor agregado regional.
8521.10.10	60% de valor agregado regional.
8521.10.90	60% de valor agregado regional.
8521.90.10	60% de valor agregado regional.
8523.52.00	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada; B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação); E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar ou processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8523.59.10	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8525.50.19	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8525.50.29	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8525.60.10	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.

8537.10.20	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.
8540.20.20	60% de valor agregado regional.
8540.50.20	Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.
8541.10.22	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada; B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação); E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8541.10.29	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada; B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação); E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8541.10.92	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada; B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação); E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8541.10.99	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada; B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação); E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8541.29.20	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada; B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação); E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8541.30.21	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada; B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação); E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8541.30.29	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada; B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação); E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8541.40.16	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada; B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação); E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8541.40.21	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada; B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação); E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.

8541.40.22	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada; B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação); E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8541.40.26	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada; B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação); E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8541.40.31	CÉLULAS FOTOVOLTÁICAS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Processamento físico-químico referente às etapas de divisão, texturização e metalização; B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; e D. Marcação (identificação).
8541.40.32	CÉLULAS FOTOVOLTÁICAS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Processamento físico-químico referente às etapas de divisão, texturização e metalização; B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; e D. Marcação (identificação).
8541.50.20	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada; B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação); E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8542.32.21	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada; B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação); E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8542.32.29	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada; B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação); E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8542.32.91	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada; B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação); E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8542.33.90	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada; B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação); E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8542.39.39	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada; B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação); E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8542.39.99	COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada; B. Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; D. Marcação (identificação); E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monolíticos projetados em algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas "A" e "B" anteriores.
8543.10.00	60% de valor agregado regional.
8543.20.00	60% de valor agregado regional.
8543.30.00	60% de valor agregado regional.
8543.70.12	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8543.70.14	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.

8543.70.15	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8543.70.19	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8543.70.39	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8543.70.91	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8543.70.92	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8543.70.99	Mudança de posição e cumprimento do seguinte processo produtivo: A - Montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes; e D - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.
8544.70.10	CABOS ÓPTICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Pintura de fibras; B. Reunião de fibras em grupos; C. Reunião para formação de núcleos; D. Extrusão da capa ou aplicação de armação metálica e marcação; E. Será admitida a realização das atividades descritas nos itens "A" e "B" por terceiros, desde que efetuada em um dos Estados Partes; F. As empresas deverão realizar atividades de engenharia referentes ao desenvolvimento e adaptação do produto a sua fabricação e teste (ensaios) de aceitação operacional; e G. Os cabos ópticos deverão utilizar fibras ópticas que atendam o requisito específico de origem definido para as mesmas.
8544.70.30	CABOS ÓPTICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Pintura de fibras; B. Reunião de fibras em grupos; C. Reunião para formação de núcleos; D. Extrusão da capa ou aplicação de armação metálica e marcação; E. Será admitida a realização das atividades descritas nos itens "A" e "B" por terceiros, desde que efetuada em um dos Estados Partes; F. As empresas deverão realizar atividades de engenharia referentes ao desenvolvimento e adaptação do produto a sua fabricação e teste (ensaios) de aceitação operacional; e G. Os cabos ópticos deverão utilizar fibras ópticas que atendam o requisito específico de origem definido para as mesmas.

8544.70.90	CABOS ÓPTICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Pintura de fibras; B. Reunião de fibras em grupos; C. Reunião para formação de núcleos; D. Extrusão da capa ou aplicação de armação metálica e marcação; E. Será admitida a realização das atividades descritas nos itens "A" e "B" por terceiros, desde que efetuada em um dos Estados Partes; F. As empresas deverão realizar atividades de engenharia referentes ao desenvolvimento e adaptação do produto a sua fabricação e teste (ensaios) de aceitação operacional; e G. Os cabos ópticos deverão utilizar fibras ópticas que atendam o requisito específico de origem definido para as mesmas.
8601.10.00	60% de valor agregado regional.
8601.20.00	60% de valor agregado regional.
8602.10.00	60% de valor agregado regional.
8602.90.00	60% de valor agregado regional.
8603.10.00	60% de valor agregado regional.
8603.90.00	60% de valor agregado regional.
8604.00.10	60% de valor agregado regional.
8604.00.90	60% de valor agregado regional.
8605.00.10	60% de valor agregado regional.
8605.00.90	60% de valor agregado regional.
8606.10.00	60% de valor agregado regional.
8606.30.00	60% de valor agregado regional.
8606.91.00	60% de valor agregado regional.
8606.91.00	60% de valor agregado regional.
8606.92.00	60% de valor agregado regional.
8606.99.00	60% de valor agregado regional.
8607.11.10	60% de valor agregado regional.
8607.11.20	60% de valor agregado regional.
8607.12.00	60% de valor agregado regional.
8607.19.11	60% de valor agregado regional.
8607.19.19	60% de valor agregado regional.
8607.19.90	60% de valor agregado regional.
8607.21.00	60% de valor agregado regional.
8607.29.00	60% de valor agregado regional.
8607.30.00	60% de valor agregado regional.
8607.91.00	60% de valor agregado regional.
8607.99.00	60% de valor agregado regional.
8608.00.11	60% de valor agregado regional.
8608.00.12	60% de valor agregado regional.
8608.00.90	60% de valor agregado regional.
8609.00.00	60% de valor agregado regional.
8701.10.00	60% de valor agregado regional.
8701.30.00	60% de valor agregado regional.
8701.90.10	60% de valor agregado regional
8704.10.10	60% de valor agregado regional.

8704.10.90	60% de valor agregado regional.
8706.00.20	60% de valor agregado regional.
8707.90.10	60% de valor agregado regional.
8708.29.11	60% de valor agregado regional.
8708.29.12	60% de valor agregado regional.
8708.29.13	60% de valor agregado regional.
8708.29.14	60% de valor agregado regional.
8708.29.19	60% de valor agregado regional.
8708.30.11	60% de valor agregado regional.
8708.40.11	60% de valor agregado regional.
8708.40.19	60% de valor agregado regional.
8708.50.11	60% de valor agregado regional.
8708.50.12	60% de valor agregado regional.
8708.50.19	60% de valor agregado regional.
8708.50.91	60% de valor agregado regional.
8708.70.10	60% de valor agregado regional.
8708.94.11	60% de valor agregado regional.
8708.94.12	60% de valor agregado regional.
8708.94.13	60% de valor agregado regional.
8709.11.00	60% de valor agregado regional.
8709.19.00	60% de valor agregado regional.
8709.90.00	60% de valor agregado regional.
8714.99.10	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
8714.99.90	Mudança de posição tarifária e 60% de valor agregado regional.
8716.20.00	60% de valor agregado regional.
8802.11.00	60% de valor agregado regional.
8802.12.10	60% de valor agregado regional.
8802.12.90	60% de valor agregado regional.
8802.20.10	60% de valor agregado regional.
8802.20.21	60% de valor agregado regional.
8802.20.22	60% de valor agregado regional.
8802.20.90	60% de valor agregado regional.
8802.30.10	60% de valor agregado regional.
8802.30.21	60% de valor agregado regional.
8802.30.29	60% de valor agregado regional.
8802.30.31	60% de valor agregado regional.
8802.30.39	60% de valor agregado regional.
8802.30.90	60% de valor agregado regional.
8802.40.10	60% de valor agregado regional.
8802.40.90	60% de valor agregado regional.
8802.60.00	60% de valor agregado regional.
8803.10.00	60% de valor agregado regional.
8803.20.00	60% de valor agregado regional.
8803.30.00	60% de valor agregado regional.
8803.90.00	60% de valor agregado regional.
8805.10.00	60% de valor agregado regional.
8805.21.00	60% de valor agregado regional.
8805.29.00	60% de valor agregado regional.
8901.10.00	60% de valor agregado regional.
8901.20.00	60% de valor agregado regional.
8901.30.00	60% de valor agregado regional.
8901.90.00	60% de valor agregado regional.
8902.00.10	60% de valor agregado regional.
8902.00.90	60% de valor agregado regional.
8904.00.00	60% de valor agregado regional.
8905.10.00	60% de valor agregado regional.
8905.20.00	60% de valor agregado regional.
8905.90.00	60% de valor agregado regional.
8906.10.00	60% de valor agregado regional.
8906.90.00	60% de valor agregado regional.
8907.10.00	60% de valor agregado regional.
8907.90.00	60% de valor agregado regional.
9001.10.11	FIBRAS ÓPTICAS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Processamento físico-químico que resulte na obtenção da pré-forma; B. Estiramento da fibra; C. Teste; D. Embalagem; E. Será admitida a realização da atividade descrita no item "A" por terceiros, desde que efetuada em um dos Estados Partes; e F. As empresas deverão realizar atividades de engenharia referentes ao desenvolvimento e adaptação do produto a sua fabricação e teste (ensaios).
9001.10.19	FIBRAS ÓPTICAS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Processamento físico-químico que resulte na obtenção da pré-forma; B. Estiramento da fibra; C. Teste; D. Embalagem; E. Será admitida a realização da atividade descrita no item "A" por terceiros, desde que efetuada em um dos Estados Partes; e F. As empresas deverão realizar atividades de engenharia referentes ao desenvolvimento e adaptação do produto a sua fabricação e teste (ensaios).
9001.10.20	CABOS ÓPTICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Pintura de fibras; B. Reunião de fibras em grupos; C. Reunião para formação de núcleos; D. Extrusão da capa ou aplicação de armação metálica e marcação; E. Será admitida a realização das atividades descritas nos itens "A" e "B" por terceiros, desde que efetuada em um dos Estados Partes; F. As empresas deverão realizar atividades de engenharia referentes ao desenvolvimento e adaptação do produto a sua fabricação e teste (ensaios) de aceitação operacional; e G. Os cabos ópticos deverão utilizar fibras ópticas que atendam o requisito específico de origem definido para as mesmas.
9002.11.20	60% de valor agregado regional.
9005.80.00	60% de valor agregado regional.
9005.90.90	60% de valor agregado regional.
9006.10.00	60% de valor agregado regional.
9006.30.00	60% de valor agregado regional.
9007.19.00	60% de valor agregado regional.
9007.20.91	60% de valor agregado regional.

9018.90.94	60% de valor agregado regional.
9019.10.00	60% de valor agregado regional.
9019.20.10	60% de valor agregado regional.
9019.20.20	60% de valor agregado regional.
9019.20.30	60% de valor agregado regional.
9019.20.40	60% de valor agregado regional.
9019.20.90	60% de valor agregado regional.
9022.12.00	60% de valor agregado regional.
9022.13.11	60% de valor agregado regional.
9022.13.19	60% de valor agregado regional.
9022.13.90	60% de valor agregado regional.
9022.14.11	60% de valor agregado regional.
9022.14.12	60% de valor agregado regional.
9022.14.13	60% de valor agregado regional.
9022.14.19	60% de valor agregado regional.
9022.14.90	60% de valor agregado regional.
9022.19.10	60% de valor agregado regional.
9022.19.91	60% de valor agregado regional.
9022.19.99	60% de valor agregado regional.
9022.21.10	60% de valor agregado regional.
9022.21.20	60% de valor agregado regional.
9022.21.90	60% de valor agregado regional.
9022.29.10	60% de valor agregado regional.
9022.29.90	60% de valor agregado regional.
9022.30.00	60% de valor agregado regional.
9022.90.11	60% de valor agregado regional.
9022.90.12	60% de valor agregado regional.
9022.90.19	60% de valor agregado regional.
9022.90.80	60% de valor agregado regional.
9022.90.90	60% de valor agregado regional.
9024.10.10	60% de valor agregado regional.
9024.10.20	60% de valor agregado regional.
9024.10.90	60% de valor agregado regional.
9024.80.11	60% de valor agregado regional.
9024.80.19	60% de valor agregado regional.
9024.80.21	60% de valor agregado regional.
9024.80.29	60% de valor agregado regional.
9024.80.90	60% de valor agregado regional.
9024.90.00	60% de valor agregado regional.
9026.10.11	<p>Cumprir com o seguinte processo produtivo:</p> <p>A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso;</p> <p>B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e</p> <p>C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores.</p> <p>Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.</p>
9027.10.00	60% de valor agregado regional.
9027.20.11	60% de valor agregado regional.
9027.20.12	60% de valor agregado regional.
9027.20.19	60% de valor agregado regional.
9027.20.21	60% de valor agregado regional.
9027.20.29	60% de valor agregado regional.
9027.30.11	60% de valor agregado regional.
9027.30.19	60% de valor agregado regional.
9027.30.20	60% de valor agregado regional.
9027.50.10	60% de valor agregado regional.
9027.50.20	60% de valor agregado regional.
9027.50.30	60% de valor agregado regional.
9027.50.40	60% de valor agregado regional.
9027.50.50	60% de valor agregado regional.
9027.50.90	60% de valor agregado regional.
9027.80.11	60% de valor agregado regional.
9027.80.12	60% de valor agregado regional.
9027.80.13	60% de valor agregado regional.
9027.80.14	60% de valor agregado regional.
9027.80.20	60% de valor agregado regional.
9027.80.30	60% de valor agregado regional.
9027.80.91	60% de valor agregado regional.
9027.80.99	60% de valor agregado regional.
9027.90.10	60% de valor agregado regional.
9027.90.91	60% de valor agregado regional.
9027.90.93	60% de valor agregado regional.
9027.90.99	60% de valor agregado regional.
9028.10.11	60% de valor agregado regional.
9028.10.19	60% de valor agregado regional.
9028.30.11	<p>Cumprir com o seguinte processo produtivo:</p> <p>A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso;</p> <p>B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e</p> <p>C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores.</p> <p>Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.</p>

9032.89.89	<p>Cumprir com o seguinte processo produtivo:</p> <p>A. Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e C. Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" anteriores.</p> <p>Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposições 8471.49.3 e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-símile" dos itens 8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B". Não descaracteriza o comprimento do regime de origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.</p>
9032.90.10	CIRCUITOS IMPRESSOS MONTADOS COM COMPONENTES ELÉTRICOS OU ELETRÔNICOS. : Montagem e soldagem nas placas de circuito impresso de todos os componentes, sempre que estes não partam da subposição 8473.30.
9402.90.10	60% de valor agregado regional.
9402.90.20	60% de valor agregado regional.
9406.00.10	60% de valor agregado regional.
9406.00.92	60% de valor agregado regional.

Notas:

¹ Exceto o produto definido como "premesclas que contenham vitaminas com suporte de substâncias orgânicas nutritivas e/ou de substâncias inorgânicas especificamente elaboradas para serem agregadas à ração animal completa".

² Aplica-se somente a:

Aos tecidos de malha de largura não superior a 30 cm, contendo em peso, 5% ou mais de fios elastômeros ou de fios de borracha, exceto: os veludos e pelúcias (incluídos os tecidos denominados de "felpa longa" ou de "pêlo comprido") e tecidos atoalhados (tecidos de anéis), de malha;

Aos tecidos de malha de largura não superior a 30 cm, exceto: os veludos e pelúcias (incluídos os tecidos denominados de "felpa longa" ou de "pêlo comprido") e tecidos atoalhados (tecidos de anéis), de malha; A Outros tecidos de malha-urdidura (incluídos os obtidos em teares para galões) de fibras artificiais, exceto: os veludos e pelúcias (incluídos os tecidos denominados de "felpa longa" ou de "pêlo comprido") e tecidos atoalhados (tecidos de anéis), de malha, e os tecidos de malha de largura superior a 30 cm, contendo, em peso, 5% ou mais de fios de elastômeros ou de fios de borracha.

³ Aplica-se exclusivamente aos inseticidas, fungicidas, herbicidas inibidores de germinação e reguladores de crescimento de plantas.

⁴ Aplica-se exclusivamente aos inseticidas apresentados à base de óleo mineral.

⁵ Exceto "Tubos para canos elaborados com soldagem contínua por resistência elétrica, de diâmetro superior a 590 mm e inferior a 630 mm."

⁶ Exceto "Tubos de aço aluminizado"

⁷ Somente se aplica ao seguinte produto: "trépano PDC com corpo de aço e cabeça de tungstênio".